

クォークテクノロジー

照射ユニット

UV-LED製を拡販

タッチパネル関連で引き合い

(株)クォークテクノロジー(岡山県井原市木之下町167、☎0866-621-1367)は、光源にUV-LEDを用いた照射ユニットに注力している。タッチパネル関連でUV硬化樹脂を用いた貼り合わせ工程で引き合いが多く、中国市場向けをメインに販売展開している。

同社は、エキシマランプの開発・製造から光源ユニットの開発までを手がける。この10年間でエキシマランプの寿命を1000時間から2500時間まで向上させ、出力は150mWまで拡大させた。ガラスの表面改質で引き合いが多く、これまでに半導体向けを主力に累計数百台を出荷している。小型有機EL向けでも強みを持つほか、新たに医療向けにも製品展開を開始している。

顧客は台湾と日本をメインに北米にも展開しており、固定客を数多く持つことから更新投資も多く、安定した受注があることが強みだ。

現在はタッチパネル関連で、UV硬化液状樹脂のO

増収を果したが、インフレ、繊維が減収だった。営業利益は繊維が増益だったが、ビニルセテート、インフレーションが減収で、機能材料は赤字に転落した。ビニルセテートの売上高は43億6200万円

増収を果したが、インフレ、繊維が減収だった。営業利益は繊維が増益だったが、ビニルセテート、インフレーションが減収で、機能材料は赤字に転落した。ビニルセテートの売上高は43億6200万円

テクノファイン

円筒型対応を強化

ターゲットの接合率保証

(株)テクノファイン(川崎市麻生区栗木2-16-1、☎044-986-7041)は、スパッタリング用ロータリー(円筒)ターゲットのボンディング加工に注力している。超音波による独自の品質管理で高い接合率を保証し、成膜の品質に貢献。今後の需要拡大を想定し、中国工場に生産体制を準備中だ。

接合率を保証している。接合率が低いとターゲット材料の剥離や不均一な成膜につながる可能性があり、特に大型ターゲットでは接合強度が重視されている。

ロータリーターゲットは、タッチパネルや薄膜太陽電池の生産増強には基板にフィルムを用いたデバイス登場で、今後の需要増加が期待されている。現段階で同社が取り扱うターゲットの約10%がロータリー型だが、今後は比率が高まる。特に需要拡大が見込まれる中国で生産体制の拡充を検討する。

現在、本社工場および台湾工場では主に現地ニーズに対応しているが、中国工場では4.5世代以下のプレーナー型などが中心。需要を見ながらだが、早ければ今秋にも中国でもロータリー型とプレーナー型のボンディング体制を同時に整えたい考えだ。

樹脂は、LED反射板・コネクタ用途が堅調に推移、自動車用途も拡大した。機能材料の売上高は105億6000万円(同1・1%増)で、営業利益は5000万円の赤字だった。液晶バックライトの導光板

電子ペーパーディスプレイ(EPD)の最大手、イー・インクホールディングス(台湾新竹市)は、新しい電気泳動型EPD「Carta」(写真)の量産を開始したと発表した。アマゾンが10月に発売予定の電

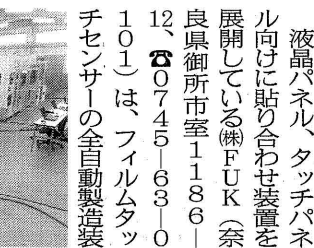
FUK

全自動化を実現へ

コスト削減、効率向上

フィルムセンサー用製造装置

液晶パネル、タッチパネル向けに貼り合わせ装置を展開している(株)FUK(奈良県御所市室1-186-12、☎0745-630101)は、フィルムタッチセンサーの全自動製造装置を開発した。セルミオット機によるタッチ製造が主流の同工程を自動化し、コスト削減や生産効率の向上に寄与できる。9月に台湾向けに1号機を納入し、順次国内外へ販売を進めている。

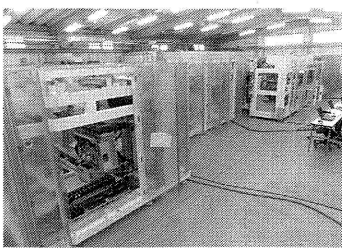


現在、同社の主力である液晶パネル、タッチパネル貼り合わせ装置に続く柱として開発した。コア技術である大気中での貼り合わせ技術に応用し、ロール状のタッチセンサーフィルムの両面にOCA(透明粘着フィルム)を全自動で貼り付け、インラインニ

一方、同社は主力の貼り合わせ装置の大型化対応を進めている。13年初頭に15・6型対応、7月に27型対応装置をラインアップし、年内に60型対応装置の開発、14年初頭の発売を予定している。タブレット端末やノートPC、大型ハイエンド液晶TVの貼り合わせニーズを獲得し、さらなる業績拡大を狙う。既存の装置の需要が好調に伸びていることもあり、14年4月期には前年比約1・5倍の13億円の売り上げを計画している。

同社はターゲット材料のボンディングを専門に請け負うボンディング・ソリューション。バックギンゲ材料、ターゲット材料を問わずにボンディングできる独自の接合技術を持ち、市場で用いられるすべてのサイズ形状のターゲットに対応できるのを強みとしている。

バックギンゲ用のプレートやチューブとターゲットの接合材料には、一般的にインジウムが用いられる。同社では、接合後に超音波装置を用いて接合質を全数検査しており、95%以上の

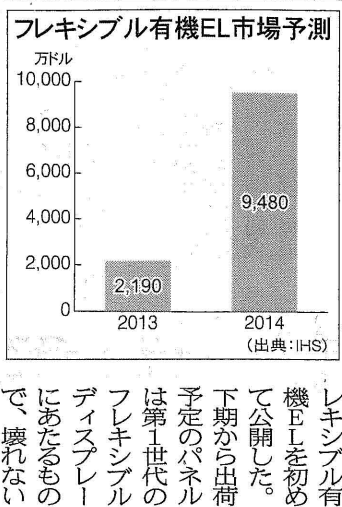


現在、同社の主力である液晶パネル、タッチパネル貼り合わせ装置に続く柱として開発した。コア技術である大気中での貼り合わせ技術に応用し、ロール状のタッチセンサーフィルムの両面にOCA(透明粘着フィルム)を全自動で貼り付け、インラインニ

一方、同社は主力の貼り合わせ装置の大型化対応を進めている。13年初頭に15・6型対応、7月に27型対応装置をラインアップし、年内に60型対応装置の開発、14年初頭の発売を予定している。タブレット端末やノートPC、大型ハイエンド液晶TVの貼り合わせニーズを獲得し、さらなる業績拡大を狙う。既存の装置の需要が好調に伸びていることもあり、14年4月期には前年比約1・5倍の13億円の売り上げを計画している。

同社はターゲット材料のボンディングを専門に請け負うボンディング・ソリューション。バックギンゲ材料、ターゲット材料を問わずにボンディングできる独自の接合技術を持ち、市場で用いられるすべてのサイズ形状のターゲットに対応できるのを強みとしている。

バックギンゲ用のプレートやチューブとターゲットの接合材料には、一般的にインジウムが用いられる。同社では、接合後に超音波装置を用いて接合質を全数検査しており、95%以上の



フレキシブル有機ELを初めて公開した。下期から出荷予定のパネルは第1世代のフレキシブルディスプレイにあたるもので、壊れない